

半导体晶圆微纳切割玻璃分化板光栅码盘激光划线盲孔定制加工

产品名称	半导体晶圆微纳切割玻璃分化板光栅码盘激光划线盲孔定制加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	华诺激光:微纳切割打孔定制 加工设备:皮秒, 纳秒 加工地:北京
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

半导体晶圆微纳切割玻璃分化板光栅码盘激光划线盲孔定制加工

晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。国内晶圆生产线以 8 英寸和 12 英寸为主。晶圆的主要加工方式为激光精密切割。

华诺激光专注于微米级的激光精密切割、钻孔、刻线、划片、雕刻和材料的打标，广泛应用于光电、电子、新能源、电光源、半导体、光学新技术、化工、冶金、电工、科研等方面，涉及包括各种金属及合金、半导体、陶瓷、各种透明材质、薄膜和聚合物等各种材料，公司已经做过1000多个基于以上材料的各种激光微加工试验和方案。